

台积电计划调涨产品价格，先进封装赛道维持高景气

——电子行业快评报告

强于大市 (维持)

2024 年 06 月 18 日

行业核心观点:

6 月 17 日, 据台湾《工商时报》报道, 在产能供不应求的情况下, 台积电将针对先进封装执行价格调涨, 预估 2025 年先进封装报价将上涨 10%-20%。

投资要点:

AI 算力加速建设, 拉动 2.5D/3D 先进封装需求: 随着 AI 超万亿参数大模型的推出, AI 加速器硬件的需求持续提升, 进一步拉动先进封装需求。**2.5D 堆叠技术方面,** 此前在 5 月的欧洲技术研讨会上, 台积电宣布计划至少到 2026 年, 以超过 60% 的复合年增长率扩大 CoWoS 产能, 因而到 2026 年底 CoWoS 产能有望增至 2023 年四倍水平。**3D 堆叠技术方面,** 台积电计划在 2026 年底之前以 100% 的复合年增长率扩大 SoIC 产能, 因而到 2026 年底 SoIC 产能有望增至 2023 年六倍水平。**但结合需求端来看,** 台积电先进封装客户中英伟达约占半数产能, AMD、博通、亚马逊、Marvell 等国际大厂均积极采用先进封装制程, 预估明年市场需求量超过 60 万片, 而台积电明年供给量预估 53 万片, 仍有 7 万片左右缺口, 供应较为紧张, 具备涨价动能。

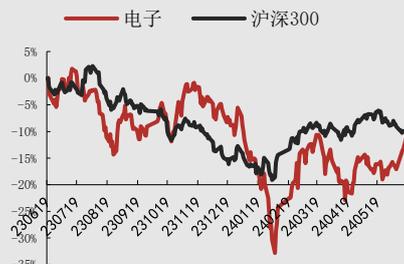
先进封装市场规模增长迅速, 大厂资本开支持续投入: 得益于移动和消费类、电信和基础设施以及汽车等终端市场需求的强劲增长, 以及高性能计算和生成式人工智能等大趋势的推动, 先进封装市场增长迅速。据 Yole, 全球先进封装市场规模将从 2023 年的 378 亿美元增长至 2029 年的 695 亿美元, 期间的复合年增长率为 10.7%。预计 2024 年, 台积电、英特尔、三星、日月光、安靠与长电科技等大厂在先进封装领域将合计投资约 115 亿美元。

Chiplet 与 2.5D 等堆叠技术相辅相成, 有望成为国产先进制程破局路径之一: Chiplet 是推动先进封装异构集成技术发展的重要解决方案, 其将系统级芯片 (SoC) 分割成容纳不同 IP 块的多个裸片, 再将这些不同的芯粒通过先进的 2.5D 或 3D 技术实现堆叠, 以实现更强大的芯片性能。Chiplet 技术具备设计灵活性和定制化特点, 可以通过封装多颗芯粒异构集成一体来提升整体性能, 同时芯粒模块化生产可以复用, 简化开发流程, 亦能提升制造良率、降低成本。在国内发展先进制程外部条件受限的背景下, Chiplet 作为算力芯片等高性能芯片领域具备较高性价比的解决方案, 有望成为国产先进制程破局路径之一。

投资建议: 大算力时代下先进封装产业趋势持续推进, 我们建议关注传统封装厂商技术升级带来的投资机会, 以及在 C 技术领域较为领先、具备量产能力的龙头厂商。

风险因素: 海外市场波动风险; 技术研发不及预期; 市场竞争加剧。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源: 聚源, 万联证券研究所

相关研究

广东省推动 AI 赋能千行百业, 加快智能经济发展

国际巨头积极布局 AIPC, 关注本周苹果 WWDC 2024

Computex 2024 召开, 大厂加速布局 AIPC

分析师: 夏清莹

执业证书编号: S0270520050001

电话: 075583223620

邮箱: xiaqy1@wlzq.com.cn

研究助理: 陈达

电话: 13122771895

邮箱: chenda@wlzq.com.cn

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街28号中海国际中心

深圳福田区深南大道2007号金地中心

广州天河区珠江东路11号高德置地广场